

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| (51) Int. Cl. ⁵ H05K 1/18 | (11) 공개번호 (43) 공개일자 | 특 1992-0007509 1992년 04월 28일 |
| (21) 출원번호 | 특 1991-0016558 | |
| (22) 출원일자 | 1991년 09월 20일 | |
| (30) 우선권 주장 | 90-250395 1990년 09월 21일 일본(JP) | |
| (71) 출원인 | 가부시끼가이샤 도시바 아오이 조이찌 일본국 가나가와켄 가와사끼시 사이와이구 호리카와조 72번지 도시바 마이크로 일렉트로닉스 가부시끼가이샤 다게다이 마사다까 일본국 가나가와켄 가와사끼시 가와사끼구 에끼마에혼쑈 25-1 | |
| (72) 발명자 | 가쯔마따아끼오 일본국 가나가와켄 가와사끼시 사이와이구 고무카이 도시바쑈1 가부시끼가이샤 도시바 다마가와워क्स 내 다니모또히데시 일본국 가나가와켄 가와사끼시 가와사끼구 에끼마에혼쑈25-1 도시바 마이크로 일렉트로닉스 가부시끼가이샤 내 | |
| (74) 대리인 | 이상희, 구영창, 주성민 | |

심사청구 : 있음

(54) 박형 메모리 모듈

요약

내용 없음

대표도

도 1

명세서

[발명의 명칭]

박형 메모리 모듈

[도면의 간단한 설명]

제1도, 제3도 및 제5도는 각각 본 발명의 박형 메모리 모듈이 삽입되는 소켓의 한 예를 도시한 측면도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

마더보드 상에 설치된 소켓에 삽입되는 기판, 및 상기 기판의 한면 또는 양면에 탑재되는 박형 패키지에 의해 실장된 반도체 장치를 구비하는 것을 특징으로 하는 박형 메모리 모듈.

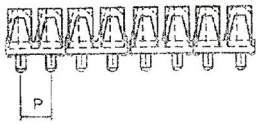
청구항 2

제1항에 있어서, 상기 박형 패키지가 박형 스몰 아웃라인 패키지인 것을 특징으로 하는 박형 메모리 모듈.

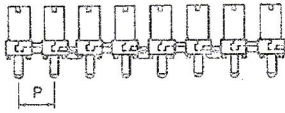
※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면1



도면3



도면4

| SIMM 규격 (mm) | |
|--------------|------|
| 1MDRAM 규격 | 3.67 |
| MDRAM 규격 | 9.07 |
| TSOP 규격 | 4.27 |

도면5

